



Title of Change:	Wafer fab transfer to ON Semiconductor Gresham, Oregon USA from ON Semiconductor Fab2, Oudenaarde, Belgium related to Fab2 sale	
Proposed Changed Material First Ship Date:	31 Dec 2021 or earlier if approved by customer	
Current Material Last Order Date:	Jun 30, 2021 with flexibility for update at FPCN issue date	
Current Material Last Delivery Date:	12months after FPCN issue date, unless otherwise mutually agreed	
Product Category:	Active components – Integrated circuits	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Alicia.Tuckett@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements. Sample requirement needs are required by end of Q1'2021	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Catherine.DeKeukeleire@onsemi.com	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 12 months prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com> .	
Change Category		
Category	Type of Change	
Process - Wafer Production	Move of all or part of wafer fab to a different location/site/subcontractor Change of gate material / dielectrics, New wafer diameter	
Description and Purpose:		
Wafer fab transfer to ON Semiconductor Gresham, Oregon USA from ON Semiconductor Fab2, Oudenaarde, Belgium due to Fab2 sale.		
NCV7751DQR2G, NCV887105D1R2G, NCV891334MW33R2G were discontinued, but was later decided to continue with these parts with the change per IPCN23658Z.		
<ul style="list-style-type: none"> PD23383Z: NCV7751DQR2G, NCV887105D1R2G (IPCN23658Z will cancel and replace PD23383Z) PD23406ZA: NCV891334MW33R2G (IPCN23658Z will cancel and replace PD23406ZA) 		
Wafer fab location	Fab2, Oudenaarde, Belgium (Current Fab)	ON Gresham, Oregon, USA (New Fab)
Wafer Diameter	Substrate: Si (150mm) 6"	Substrate: Si (200mm) 8"
Product marking change	Documented at product level at FPCN issue	
Reason / Motivation for Change:	Source/Supply/Capacity Changes	
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device will be qualified and validated based on the same Product Specification and qualification plan. No anticipated impacts.	



Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites
ON Semiconductor Gresham, Oregon		None
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Traceability guaranteed by datecode	
Reliability Data Summary:		
Qualification plan is device specific and will be provided upon request		
Electrical Characteristics Summary:		
Electrical characteristics are not impacted.		
List of Affected Parts:		
<i>Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.</i>		
Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
NCV7120FP0R2G	NA	NA
NCV7420D21R2G	NA	NA
NCV7440C1	NA	NA
NCV7681APWR2G	NA	NA
NCV7681LPWR2G	NA	NA
NCV7683DQR2G	NA	NA
NCV7708FDQR2G	NA	NA
NCV7708FDWR2G	NA	NA
NCV7751DQR2G	NA	NA
NCV7754DPR2G	NA	NA
NCV78247DQ0R2G	NA	NA
NCV78703MW0R2G	NA	NA
NCV78703MW1R2G	NA	NA
NCV78713MW0R2G	NA	NA
NCV885201D1R2G	NA	NA
NCV887001D1R2G	NA	NA
NCV887100D1R2G	NA	NA
NCV887103D1R2G	NA	NA
NCV887104D1R2G	NA	NA



NCV887105D1R2G	NA	NA
NCV887300D1R2G	NA	NA
NCV887302D1R2G	NA	NA
NCV887601D1R2G	NA	NA
NCV887701D1R2G	NA	NA
NCV887711D1R2G	NA	NA
NCV887720D1R2G	NA	NA
NCV890100MWTXG	NA	NA
NCV890104MWR2G	NA	NA
NCV890200PDR2G	NA	NA
NCV890204MWR2G	NA	NA
NCV890430MW50TXG	NA	NA
NCV891330PD33R2G	NA	NA
NCV891330PD40R2G	NA	NA
NCV891330PD50R2G	NA	NA
NCV891334MW33R2G	NA	NA
NCV898031D1R2G	NA	NA

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23658Z

発行日: 16 Nov 2020

変更件名:	Fab2 の売却に関連してオン・セミコンダクター Fab2 (ベルギー、アウデナールデ) からオン・セミコンダクター グレシャム (米国オレゴン州) へのウェハー製造工場を移管	
初回出荷予定日:	31 Dec 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
現在の材料の最終注文日:	2021 年 6 月 30 日 ただし FPCN 発行日に柔軟に更新	
現在の材料の最終出荷日:	相互に別段の合意がない限り FPCN 発行日の 12 か月後	
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント - 集積回路	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Alicia.Tuckett@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所に注文するか、または < PCN.samples@onsemi.com > にお問い合わせください。サンプルは、この変更通知の発行から 45 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < Catherine.DeKeukeleire@onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 12 か月前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
変更カテゴリ:	変更種別	
プロセス-ウェハー製造	ウェハー製造工場のすべてまたは一部を異なる場所/拠点/外注に移転、ゲート材料/誘電体の変更、新しいウェハー径	
説明および目的:		
Fab2 の売却により、オン・セミコンダクター Fab2 (ベルギー、アウデナールデ) からオン・セミコンダクター グレシャム (米国オレゴン州) にウェハー製造工場を移管します。		
NCV7751DQR2G、NCV887105D1R2G、NCV891334MW33R2G は製造中止になっていましたが、その後 IPCN23658Z による変更により、これらの製品を製造継続することが決定されました。		
<ul style="list-style-type: none"> PD23383Z: NCV7751DQR2G、NCV887105D1R2G (IPCN23658Z は通知を取り消し、PD23383Z を差し替えます。) PD23406ZA: NCV891334MW33R2G (IPCN23658Z は通知を取り消し、PD23406ZA を差し替えます。) 		
ウェハー製造拠点	Fab2, Oudenaarde, Belgium (Current Fab)	ON Gresham, Oregon, USA (New Fab)
ウェハー径	Substrate: Si (150mm) 6"	Substrate: Si (200mm) 8"
製品マーキング変更	FPCN 発行時の製品レベルで記載されます	
変更の理由 / 動機:	ソース/供給/容量の変更	
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響	製品は同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。製品は認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。 予想される影響はありません。	



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23658Z

発行日: 16 Nov 2020

影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Gresham, Oregon	なし	
部品の表示 / 変更の追跡可能性:	トレーサビリティは日付コードにより保証されます。	
信頼性データの要約:		
認証計画は製品固有であり、ご要望に応じて提供いたします		
電気的特性の要約:		
電気的特性への影響はありません。		
影響を受ける部品の一覧:		
注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メール顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。		
現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
NCV7120FP0R2G	NA	NA
NCV7420D21R2G	NA	NA
NCV7440C1	NA	NA
NCV7681APWR2G	NA	NA
NCV7681LPWR2G	NA	NA
NCV7683DQR2G	NA	NA
NCV7708FDQR2G	NA	NA
NCV7708FDWR2G	NA	NA
NCV7751DQR2G	NA	NA
NCV7754DPR2G	NA	NA
NCV78247DQ0R2G	NA	NA
NCV78703MW0R2G	NA	NA
NCV78703MW1R2G	NA	NA
NCV78713MW0R2G	NA	NA
NCV885201D1R2G	NA	NA
NCV887001D1R2G	NA	NA
NCV887100D1R2G	NA	NA
NCV887103D1R2G	NA	NA



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23658Z

発行日: 16 Nov 2020

NCV887104D1R2G	NA	NA
NCV887105D1R2G	NA	NA
NCV887300D1R2G	NA	NA
NCV887302D1R2G	NA	NA
NCV887601D1R2G	NA	NA
NCV887701D1R2G	NA	NA
NCV887711D1R2G	NA	NA
NCV887720D1R2G	NA	NA
NCV890100MWTXG	NA	NA
NCV890104MWR2G	NA	NA
NCV890200PDR2G	NA	NA
NCV890204MWR2G	NA	NA
NCV890430MW50TXG	NA	NA
NCV891330PD33R2G	NA	NA
NCV891330PD40R2G	NA	NA
NCV891330PD50R2G	NA	NA
NCV891334MW33R2G	NA	NA
NCV898031D1R2G	NA	NA



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
NCV7681APWR2G		NA	NA	
NCV7708FDWR2G		NA	NA	
NCV7751DQR2G		NA	NA	
NCV887001D1R2G		NA	NA	
NCV887100D1R2G		NA	NA	
NCV887103D1R2G		NA	NA	
NCV887104D1R2G		NA	NA	
NCV887300D1R2G		NA	NA	
NCV890200PDR2G		NA	NA	
NCV890430MW50TXG		NA	NA	
NCV7683DQR2G		NA	NA	